

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第2区分

【発行日】令和5年6月16日(2023.6.16)

【国際公開番号】WO2022/158460

【出願番号】特願2022-576697(P2022-576697)

【国際特許分類】

B 2 3 K 35/363(2006.01)

H 0 5 K 3/34(2006.01)

【F I】

B 2 3 K 35/363 D

H 0 5 K 3/34 5 0 4 A

10

【手続補正書】

【提出日】令和5年4月6日(2023.4.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

熱可塑性樹脂(A)及び架橋剤(B)を含むはんだ接合用樹脂組成物であって、
溶剤(C)を含み、
前記溶剤を蒸発させて固化することにより回路部材を仮固定することを特徴とする、
はんだ接合用樹脂組成物。

【請求項2】

フラックス剤(D)を含む、請求項1に記載のはんだ接合用樹脂組成物。

【請求項3】

前記熱可塑性樹脂(A)がフェノキシ樹脂である、請求項1又は2に記載のはんだ接合用樹脂組成物。

30

【請求項4】

前記架橋剤(B)が酸無水物(b1)であって、前記酸無水物(b1)が特有の原子団(-CO・O・OC-)を2つ以上有している、請求項1~3のいずれか一項に記載のはんだ接合用樹脂組成物。

【請求項5】

請求項1~4のいずれか一項に記載のはんだ接合用樹脂組成物を用いたはんだ接合方法であって、下記(i)~(v)のステップを有することを特徴とする、はんだ接合方法。

(i) 液状の前記はんだ接合用樹脂組成物を準備するステップ

(ii) 前記(i)に記載の液状のはんだ接合用樹脂組成物を基板の電極を有する面又は回路部材に塗布するステップ

40

(iii) 基板の電極を有する面に塗布された前記液状のはんだ接合用樹脂組成物に回路部材を配置する、又は前記液状のはんだ接合用樹脂組成物が塗布された回路部材を基板の電極を有する面に配置するステップ

(iv) 所定温度及び所定時間の加熱により前記液状のはんだ接合用樹脂組成物を固化させて、前記回路部材を仮固定するステップ

(v) 前記固化されたはんだ接合用樹脂組成物をはんだの融点以上の温度に加熱するステップ

【請求項6】

(i) 液状の請求項1~4のいずれか一項に記載のはんだ接合用樹脂組成物を準備する

50

ステップ

(i i) 前記 (i) に記載の液状のはんだ接合用樹脂組成物を基板の電極を有する面又は回路部材に塗布するステップ

(i i i) 基板の電極を有する面に塗布された前記液状のはんだ接合用樹脂組成物に回路部材を配置する、又は前記液状のはんだ接合用樹脂組成物が塗布された回路部材を基板の電極を有する面に配置するステップ

(i v) 所定温度及び所定時間の加熱により前記液状のはんだ接合用樹脂組成物を固化させて、前記回路部材を仮固定するステップ

(v) 前記固化されたはんだ接合用樹脂組成物をはんだの融点以上の温度に加熱するステップ

を備えたことを特徴とする回路基板の製造方法。

10

20

30

40

50